

	粤开证券、高盛（中国）证券、中国银河证券、凯基证券、光大证券、中泰证券、个人投资者（排名不分先后）
时间	2024年8月28日9:45
上市公司接待人员姓名	副总经理、董事会秘书：蒋威 证券投资部：陈小曼、陈卓璜
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司2024年半年度经营业绩和行业情况介绍</p> <p>公司实现营业收入288,109.31万元、同比增长12.29%；归属于上市公司股东的净利润1,950.10万元、同比增长7.99%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,876.26万元、同比增长353.13%。总资产1,463,915.72万元、较上年末减少1.98%；归属于上市公司股东的净资产520,167.16万元、较上年末减少2.48%。</p> <p>2024年上半年，公司整体毛利率为16.56%，同比下降8.62个百分点；期间费用率下降5.18个百分点，其中，销售费用率下降0.52个百分点，管理费用率下降1.02个百分点，研发费用率下降3.90个百分点，财务费用率增长0.26个百分点。</p> <p>报告期内，受益于行业复苏，公司营业收入保持平稳增长。净利润层面主要受FCBGA封装基板业务费用投入、子公司宜兴硅谷和广州兴科亏损拖累，其中，FCBGA封装基板项目整体费用投入32,502万元，宜兴硅谷因自身能力不足导致亏损4,979万元，广州兴科CSP封装基板项目因产能利用率不足导致亏损3,322万元。计提员工激励股份摊销及确认锐骏半导体公允价值变动损失影响超2,000万元。</p> <p>整体而言，供过于求、竞争加剧、价格下行的行业趋势并未有实质性好转，各产品类型和应用领域景气度存在一定的分化。传统多层板市场因通信、工控等行业需求疲弱而面临较大的增长压力和价格压力；人工智能、高速网络领域延续高增长态势，以及消费电子行业复苏，驱动服务器、数据存储市场成为增长最快的细分领域，18层及以上PCB板、高阶HDI板等细分市场迎来强劲的增长；半导体市场整体弱复苏、但离行业高点仍有较大差距，导致目前封装基板行业景气度仍旧不高；汽车电动化和智能化的趋势仍在延续、但面临汽车行业整体需求增长放缓的挑战，与汽车电子、电池管理系统相关的PCB和FPC成长速度可能会放缓。根据Prismark报</p>

告，预期2028年全球PCB行业市场规模将达到904.13亿美元，2023-2028年复合增长率为5.4%。其中，高多层高速板（18层及以上）、高阶HDI板和封装基板领域有望实现优于行业的增长速度，预期2028年市场规模分别为27.80、148.26、190.65亿美元，2023-2028年复合增长率分别为10.0%、7.1%、8.8%。

二、FCBGA封装基板项目的进展情况介绍

公司FCBGA封装基板项目为公司战略性投资，截至2024年6月底累计投资规模已超30亿，工厂审核、产品认证、市场开拓等各项工作正按计划推进。截至2024年6月底公司已累计通过10家客户验厂，并陆续进入样品认证阶段；产品良率稳步提升，低层板良率突破92%、高层板良率稳定在85%以上，已具备20层及以下产品的量产能力，最小线宽线距达9/12um，最大产品尺寸为120*120mm。目前低层板已进入持续小批量生产阶段，高层板产品封测和可靠性验证在持续推进中，目前已反馈的产品封测结果均为未发现基板异常。

三、CSP封装基板业务情况介绍

公司CSP封装基板业务在坚守存储芯片赛道的基础上，将进一步提升射频类产品比重，优化产品结构。报告期内受益于存储芯片行业复苏和主要存储客户的份额提升，公司CSP封装基板业务收入实现较快增长，但广州兴科项目仍处于主要客户认证阶段，尚未实现大批量订单导入，产能利用率不足导致亏损3,322万元。

CSP封装基板下游应用占比：存储类占比约70%，应用处理器芯片、传感器芯片、射频芯片等其他相关占比约30%。

四、公司传统PCB业务介绍

报告期内，公司PCB业务实现收入217,010.22万元、同比增长7.48%，毛利率27.09%、同比下降2.19个百分点。毛利率下滑主要受宜兴硅谷自身能力和价格竞争激烈的影响。子公司宜兴硅谷专注于通信和服务器领域，虽实现国内大客户量产突破，但因自身能力不足导致产能未能充分释放，实现收入30,370.12万元、同比下降8.83%，亏损4,979.13万元。Fineline实现收入75,879.14万元、同比下降14.42%，净利润8,781.84万元、同比下降8.87%。北京兴斐受益于战略客户高端手机业务的恢复性增长和份额提升，实现收入39,803.32万元、同比增长11.75%，净利润5,826.23万元。

总体而言，公司PCB样板业务维持稳定，北京兴斐HDI板和类载板（SLP）业务稳定增长，PCB多层板量产业务因自身能力不足导致表现落后于行业主要竞争对手，公司已对宜兴硅谷主要管理人员进行调整，并同步导入数字化体系，预期年底有望实现经营好转。

五、FCBGA封装基板客户认证流程介绍

公司FCBGA封装基板项目的客户认证是持续进行的，因半导体行业的认证标准非常严格，每个客户的导入都需要进行技术评级、体系认证、产品认证和可靠性验证，其中工厂的技术评级和体系认证需要约6个月时间完成，产品认证的周期也需要6个月左右；完成工厂审核和产品认证之后，才会进入小批量生产，后期根据质量、技术、交付等表现逐步进入大批量量产阶段。从行业经验看，建厂-工厂审核-产品认证-量产的周期通常需要18个月左右。

六、兴森转债的后续计划

公司已于2024年8月22日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于不向下修正“兴森转债”转股价格的议案》，同意不向下修正转股价格，同时自董事会审议通过之日起未来三个月内，如再次触发“兴森转债”转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。自本次董事会审议通过之日起满三个月之后，若再次触发“兴森转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“兴森转债”转股价格的向下修正权利。

七、北京兴斐电子有限公司经营情况介绍

北京兴斐主要产品包括HDI板、FCCSP基板和采用BT材质的FCBGA基板，应用领域包括高端手机主板和副板、光模块等。

2024年上半年北京兴斐受益于战略客户高端手机业务的恢复性增长和份额提升，实现收入39,803.32万元、同比增长11.75%，净利润5,826.23万元，经营表现稳定，利润表现较好。在手机领域主要客户以韩系和国内主流手机品牌的高端机型为主。光模块目前景气度较高，北京兴斐已逐步完成国内相关客户的验厂及打样工作，未来几年，光模块业务会是北京兴斐重要的增量所在。

八、封装基板国产化的驱动力介绍？

第一是国家政策引导，在特定领域需要打造全国产化的供应链体系

	<p>以保障信息安全和数据安全；其次就是下游客户打造安全供应链的内在驱动，目前高端封装基板主要由日韩及台湾厂商供应，在行业供不应求的时候，他们都优先保障欧美客户的需求，国内的芯片设计公司和封装厂商会遭遇交期长、价格高、后续技术交流困难等情况，影响自身业务的发展。还有就是参考PCB行业发展，目前国内PCB产业快速发展，产业配套齐备，低成本及高效率的优势和高覆盖的物流体系，也是发展国产化供应链的优势和驱动力之一，长期来看，内资封装基板厂商在完成大客户突破和实现量产后，有望复制传统PCB行业过去十年的发展路径。</p> <p>公司目前处于树立品牌和增强客户信心的阶段，并继续苦练内功，不断进行工艺能力创新及市场拓展，实现产品和技术层面的持续升级，为顺利量产打下基础。</p>
附件清单	无
日期	2024年8月28日